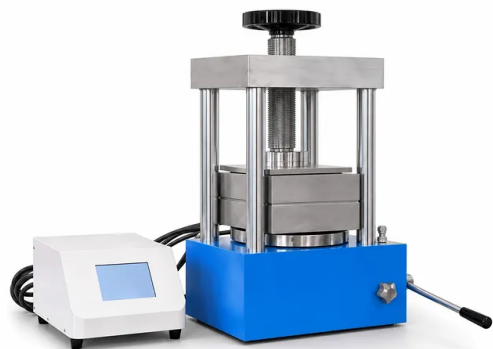


Интегрированный Горячий Пресс 24 Тонны 200X200 Мм Для Подготовки Лабораторных Образцов

Артикул: XP55



введение

Профессиональный интегрированный горячий пресс с усилием зажима 24 тонны и нагреваемыми плитами 200x200 мм, идеально подходит для исследований аккумуляторов, испытания материалов и подготовки образцов. Точное управление температурой до 300°C обеспечивает надежные и стабильные результаты.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Прессование электродов и электролитов аккумуляторов	Уплотнение порошков катода/анода и формирование таблеток твердотельных электролитов для литий-ионных и аккумуляторов следующего поколения.	Равномерное распределение плотности предотвращает горячие точки и обеспечивает стабильную ионную проводимость по всей таблетке.
Тиснение и ламинирование полимерных пленок	Термическое склеивание многослойных полимерных пленок, герметизация микрожидкостных чипов и текстурирование поверхности для устройств lab-on-a-chip.	Точный контроль температуры и давления сохраняет нежные наноструктуры без термического разрушения.
Подготовка таблеток для Фурье-ИК и РФА	Производство прозрачных таблеток КВг для инфракрасной спектроскопии и сплавленных бусин для рентгенофлуоресцентного анализа.	Устраняет воздушные включения и вариации толщины, обеспечивая воспроизводимые базовые линии спектра.
Разработка композитных материалов	Горячее прессование металлматричных композитов, полимеров, армированных керамикой, и консолидация препрегов из углеродного волокна.	Максимизирует пропитку волокна и устранение пустот под контролируемыми профилями тепла и давления.
Пилотное производство фармацевтических таблеток	Мелкосерийное прессование порошковых смесей в таблетки для испытаний рецептур и исследований стабильности.	Полная регистрация данных параметров прессования помогает в документации FDA/EMA и исследованиях масштабирования.
Спекание в порошковой металлургии	Предварительное уплотнение металлических и керамических порошков при повышенных температурах перед окончательным спеканием.	Увеличивает плотность в зеленом состоянии и снижает усадку при спекании, улучшая точность формы.
Бонирование полупроводниковых пластин	Термокомпрессионное бонирование кремниевых пластин или сборок chip-on-flex с использованием контролируемой силы и температуры.	Обеспечивает равномерные линии связи без пустот, что критично для изготовления микроэлектромеханических систем (МЭМС).

Параметр	XP55
Модель	XP55
Усилие пресса	0 – 24 тонны
Рабочая температура плит	Окр. среда - 300 °C
Мощность нагрева (Всего)	1200 Вт (2 × 600 Вт)
Размеры плит	200 × 200 мм
Охлаждение плит	Интегрированная циркуляция воды
Управление температурой	Двухзонный ПИД со стабильностью ±2 °C

Параметр	XP55
Дисплей и управление	4,3-дюймовый сенсорный экран, программируемый
Питание	220 В, 50 Гц, однофазное
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	950 x 260 x 525 мм
Чистый вес	180 кг